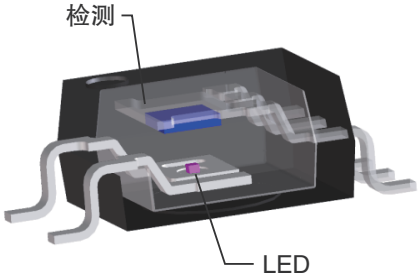
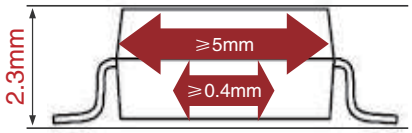
TOSHIBA
Leading Innovation >>>

SO6 / SO4的封装和结构

最新的SO6和SO4封装的东芝车规级光耦

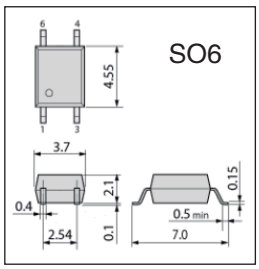


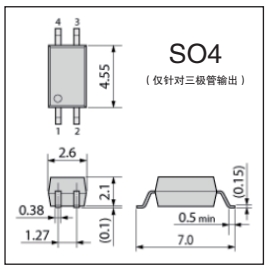


特点：

- 爬电距离和电气间隙≥5毫米
- 内部绝缘厚度≥0.4毫米
- 封装高度低≤2.3毫米
- 绝缘电压＝3750Vrms（最小值）

尺寸：





TOSHIBA
Leading Innovation >>>

过往的车载业务概述

Facts & Figures

- 15年以上的车载业务历史
  东芝开始车载光耦业务始于2000年！
- 1亿片以上的光耦已经在现场应用
  累积车规光耦的销售出货数量超过1亿片
- 东芝光耦在车载市场上的市场份额＞50%
  最主要的车载光耦的业务是电动车和混动车，日系的汽车制造商目前在该领域处于领先地位
- 新的产品线（第4代 TLX系列产品）目前在全球范围内进行推广介绍，并符合AEC–Q101认证